

2024-2030年中国光芯片行业 分析与发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国光芯片行业分析与发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202401/433873.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

光芯片是整个光通信系统的核心，主要包括激光器、光电探测器、激光调制器、PLC/MEMS芯片等。其中激光器、光电探测器、激光调制器等均是需要外加能源驱动的有源器件，是实现光电转换的核心功能器件；PLC/MEMS芯片则是利用平面光波导或微机电技术的无源器件芯片，可用来生产光分路器、AWG光栅和VMUX波分复用器等，实现光信号的连接、耦合、分路、波长复用等功能。

高端光芯片是制约我国光通信产业链发展的关键因素。目前，我国在高端光芯片制造上与与国际主流器件商仍有较大差距。在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带、华工正源等少数厂商能量产10G以下速率芯片，25G基本依赖进口，相干光模块中应用的窄线宽可调谐激光器、MZ调制器等也都依赖进口。在无源芯片方面，PLC光分路器芯片国内光迅科技、仕佳光子、鸿辉光通等已实现批量供应，AWG芯片仅光迅科技、仕佳光子等可以提供，应用于高维数ROADM（可重构光分插复用）和OXC（光交叉连接）设备的WSS（波长选择开关）芯片也主要依赖进口。

电芯片一方面实现对光芯片工作的配套支撑，如LD（激光驱动器）、TIA（跨阻放大器）、CDR（时钟和数据恢复电路），一方面实现电信号的功率调节，如MA（主放），另一方面实现一些复杂的数字信号处理，如调制、相干信号控制、串并/并串转换等。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国光芯片行业分析与发展前景预测报告》共七章。首先介绍了中国光芯片行业市场发展环境、光芯片整体运行态势等，接着分析了中国光芯片行业市场运行的现状，然后介绍了光芯片市场竞争格局。随后，报告对光芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国光芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对光芯片产业有个系统的了解或者想投资中国光芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国光芯片行业发展综述

1.1中国光芯片的概念

1.1.1光芯片的定义

1.1.2光芯片的分类

1.2中国光芯片行业发展环境分析

1.2.1行业发展经济环境分析

1.2.2行业发展政策环境分析

(1) 行业发展主要影响政策汇总

(2) 行业发展主要政策解读

1.2.3行业发展社会环境分析

1.2.4行业发展技术环境分析

1.3光芯片行业产业链简介

第2章：光芯片所属行业发展现状及趋势分析

2.1光芯片行业市场现状分析

2.1.1行业发展主要推动因素

2.1.2行业发展规模分析

2.2光芯片行业竞争分析

2.2.1行业区域竞争分析

2.2.2行业企业竞争分析

2.3光芯片行业领先企业分析

2.3.1台湾联亚

2.3.2英国IQE

2.3.3日本三菱

2.3.4美国Avago

2.4光芯片行业发展趋势

第3章：中国光芯片所属行业发展现状及趋势分析

光模块芯片具有极高的技术壁垒和复杂的工艺流程，因而是光模块BOM成本结构中占比最大的部分。光芯片的成本占比通常在40%-60%，电芯片的成本占比通常在10%-30%之间，越高速、高端的光模块电芯片成本占比越高，但规模优势可以增加采购的议价能力。

3.1中国光芯片行业发展特点分析

3.1.1光芯片在光器件/模块中的成本占比高

3.1.2光芯片行业竞争者数量较少

3.2中国光芯片行业发展存在问题分析

3.2.1产品进口依赖度高，尤其是高端产品领域

- 3.2.2国内企业缺乏国际竞争力
- 3.2.3国内企业垂直整合能力较弱
- 3.3中国光芯片行业市场规模分析
 - 3.3.1行业市场需求现状
 - 3.3.2行业进口替代需求空间测算
- 3.4中国光芯片行业竞争分析
 - 3.4.1行业总体竞争格局
 - 3.4.2国内企业竞争力分析
- 3.5中国光芯片行业发展趋势分析

第4章：中国光芯片细分市场分析

- 4.1光芯片主要应用场景分析
- 4.2光通信领域光芯片需求分析
 - 4.2.1光通信领域对光芯片的应用需求
 - 4.2.2光通信领域发展现状
 - 4.2.3光通信领域光芯片需求规模及预测
- 4.3消费电子领域光芯片需求分析
 - 4.3.1消费电子领域对光芯片的应用需求
 - 4.3.2消费电子领域发展现状
 - 4.3.3消费电子领域光芯片需求规模及预测

第5章：中国光芯片行业技术发展方向及规划

- 5.1行业最新技术进展
- 5.2行业中长期技术发展路线分析
 - 5.2.1行业中长期重点发展产品
 - 5.2.2行业中长期重点产品技术发展目标
- 5.3行业企业技术发展规划布局
- 5.4G产业发展对光芯片技术发展影响
 - 5.4.1G产业技术进展
 - 5.4.2G产业部署对光芯片行业技术要求
 - 5.4.3G产业对光芯片需求测算

第6章：中国光芯片行业企业战略布局

6.1中国光芯片行业企业发展总体概况

6.2中国光芯片行业领先企业战略布局

6.2.1武汉光迅科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业光芯片布局
- (4) 企业经营情况分析
- (5) 企业重点客户分析

6.2.2海信宽带

- (1) 企业发展简况
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业光芯片布局
- (4) 企业经营情况分析
- (5) 企业重点客户分析

6.2.3华工科技产业股份有限公司

- (1) 企业发展简况
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业光芯片布局
- (4) 企业经营情况分析
- (5) 企业重点客户分析

6.2.4飞昂通讯科技南通有限公司

- (1) 企业发展简况
- (2) 企业主营业务分析
- (3) 企业光芯片布局
- (4) 企业经营情况分析
- (5) 企业重点客户分析

6.2.5其他企业光芯片研发进展

第7章：中国光芯片行业投资策略及前景分析

7.1中国光芯片行业投资现状分析

7.1.1行业投资壁垒分析

(1) 资金壁垒

(2) 技术壁垒

7.1.2行业投资方向分析

(1) 高端产品投资

(2) 产业链投资

7.1.3行业近年投资事项

7.2中国光芯片行业投资前景判断

7.2.1行业投资风险分析

(1) 技术风险

(2) 市场风险

7.2.2行业投资机会分析

(1) 政策鼓励

(2) 中国5G产业迅速发展

7.2.3行业投资价值分析

7.2.4行业投资前景判断

7.3中国光芯片行业投资策略建议

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202401/433873.html>